

1/9/1 DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

007984881 **Image available**

WPI Acc No: 1989-249993/198935

XRPX Acc No: N89-190563

**Handling system for cleaning circuit boards - has fluid
drawing across boards by suction unit in bath**

Patent Assignee: GEBR SCHMID GMBH & CO (SCHM-N); GEBR SCHMID GMBH (SCHM-N)

Inventor: SCHMID D C

Number of Countries: 011 Number of Patents: 005

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 329807	A	19890830	EP 88102800	A	19880225	198935 B
EP 329807	B1	19930331	EP 88102800	A	19880225	199313
DE 3879929	G	19930506	DE 3879929	A	19880225	199319
			EP 88102800	A	19880225	
ES 2039486	T3	19931001	EP 88102800	A	19880225	199344
EP 329807	B2	20030122	EP 88102800	A	19880225	200308

Priority Applications (No Type Date): EP 88102800 A 19880225

Cited Patents: DE 2606984; EP 204609; FR 2412357

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
EP 329807	A	G	7		
Designated States (Regional): AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE					
EP 329807	B1	G	6	H05K-013/00	
Designated States (Regional): AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE					
DE 3879929	G			H05K-013/00	Based on patent EP 329807
ES 2039486	T3			H05K-013/00	Based on patent EP 329807
EP 329807	B2	G		H05K-013/00	
Designated States (Regional): AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE					

Abstract (Basic): EP 329807 A

The handling system has a liquid bath (2) with a series of feed roller pairs (7,8,9) that allow the boards to be fed horizontally through the bath. The liquid is supplied to the bath by a pumped circuit and a level (13) maintained.

In the lower half of the bath is a nozzle unit (14) that spans the width of the board and is coupled to a suction pump. A specific gap (16) is maintained between the nozzle and the board. When suction is applied liquid is drawn across the surface and through the holes in the board.

ADVANTAGE - Suction unit provides efficient cleaning of small circuit board holes.

1/3

Abstract (Equivalent): EP 329807 B

The handling system has a liquid bath (2) with a series of feed roller pairs (7,8,9) that allow the boards to be fed horizontally through the bath. The liquid is supplied to the bath by a pumped circuit and a level (13) maintained.

In the lower half of the bath is a nozzle unit (14) that spans the width of the board and is coupled to a suction pump. A specific gap (16) is maintained between the nozzle and the board.

When suction is applied liquid is drawn across the surface and through the holes in the board.

ADVANTAGE - Suction unit provides efficient cleaning of small circuit board holes. (7pp Dwg.No.1/3)

Title Terms: HANDLE; SYSTEM; CLEAN; CIRCUIT; BOARD; FLUID; DRAW; BOARD; SUCTION; UNIT; BATH

Derwent Class: V04
International Patent Class (Main): H05K-013/00
International Patent Class (Additional): H05K-003/26
File Segment: EPI
Manual Codes (EPI/S-X): V04-R03; V04-V01

Derwent WPI (Dialog® File 351); (c) 2003 Thomson Derwent. All rights reserved.

.....

© 2003 Dialog, a Thomson business



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer: **0 329 807 A1**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 88102800.5

51 Int. Cl.4: H05K 13/00 , H05K 3/26

22 Anmeldetag: 25.02.88

Geänderte Patentansprüche gemäß Regel 86
(2) EPÜ.

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
30.08.89 Patentblatt 89/35

64 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

71 Anmelder: **Gebr. Schmid GmbH & Co.**
Robert-Bosch-Strasse 34
D-7290 Freudenstadt(DE)

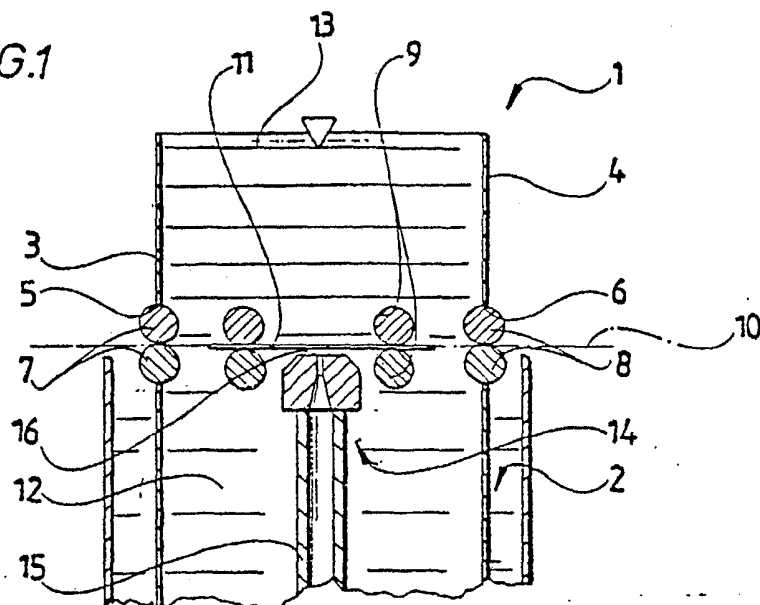
72 Erfinder: **Schmid, Dieter C., Dipl.-Ing.**
Am Schäferstich 19
D-7290 Freudenstadt(DE)

74 Vertreter: **Hoeger, Stellrecht & Partner**
Uhlandstrasse 14 c
D-7000 Stuttgart 1(DE)

54 **Vorrichtung zur Behandlung von elektrischen Leiterplatten.**

57 Um die Behandlung und Reinigung der Leiterplatten in Flüssigkeitsbädern zu intensivieren, wird eine Vorrichtung zur Behandlung von elektrischen Leiterplatten in einem oder mehreren Flüssigkeitsbädern vorgeschlagen, die gekennzeichnet ist durch eine mindestens an einer Oberfläche der Leiterplatte angeordnete Absaugung.

FIG.1



EP 0 329 807 A1

Vorrichtung zur Behandlung von elektrischen Leiterplatten

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Behandlung von elektrischen Leiterplatten in einem oder in mehreren Flüssigkeitsbädern.

Elektrische Leiterplatten werden mit Bohrungen zur Aufnahme der Anschlüsse elektrischer Elemente versehen. Diese Bohrlöcher müssen bei der Bearbeitung gereinigt werden, wobei die immer kleiner werdenden Abmessungen die zuverlässige Reinigung der Bohrlöcher erschweren. Beispielsweise werden in Leiterplatten Bohrungen mit Durchmessern von 0,2 mm benötigt, die während der Bearbeitung unter Umständen wiederholt von Trägermaterialresten, Behandlungsflüssigkeit und anderen Verunreinigungen gesäubert werden müssen.

Die Bohrungen in Leiterplatten dienen außerdem der elektrischen Verbindung von Plattenober- zu Plattenunterseite. Vor der Kontaktierung durch chemisches/galvanisches Kupfer ist ebenfalls eine gründliche Bohrlochreinigung unumgänglich.

Es ist bekannt, die Bohrlochreinigung dadurch vorzunehmen, daß eine Behandlungsflüssigkeit strahlförmig gegen die Oberfläche der Leiterplatte gerichtet wird, die dabei teilweise auch durch die Bohrlöcher hindurchtritt. Diese Reinigung kann mittels Gas- oder Flüssigkeitsstrahl erfolgen.

Obwohl auf diese Weise bei Bohrlochern größeren Durchmessers eine zufriedenstellende Reinigung erzielt werden kann, ergeben sich bei Bohrlochern mit kleineren Durchmessern bei dieser Art der Bohrlochreinigung Schwierigkeiten. Insbesondere hat sich als nachteilig herausgestellt, daß aus den Bohrlochern ausgespülte Verunreinigungen auf die Oberfläche der Leiterplatte und insgesamt in die Behandlungsflüssigkeit gelangen, so daß mit zunehmender Betriebsdauer die Gefahr einer Verunreinigung der Leiterplatte steigt.

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine gattungsgemäße Vorrichtung zur Behandlung derart zu verbessern, daß einerseits auch bei Bohrungen mit sehr kleinen Durchmessern eine effektive Reinigung der Bohrlöcher erfolgen kann und andererseits eine Ablagerung von Verunreinigung auf den Leiterplattenflächen vermieden wird.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung der eingangs beschriebenen Art gelöst, die gekennzeichnet ist durch eine mindestens an einer Oberfläche der Platte angeordnete Absaugung.

Es hat sich überraschenderweise herausgestellt, daß die Verwendung einer Absaugung an mindestens einer Plattenseite einerseits dazu führt, daß die Behandlungsflüssigkeit die Bohrlöcher mit größerer Strömungsgewindigkeit durchsetzt, so daß auf diese Weise eine einwandfreie Reinigung

der Bohrlocherinnenflächen erreicht werden kann, während andererseits durch die Behandlungsflüssigkeit ausgespülte Verunreinigungen unmittelbar durch die Absaugung aufgenommen werden, so daß eine Ablagerung dieser Verunreinigungen auf der Leiterplattenoberfläche oder in der Behandlungsflüssigkeit vermieden wird.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Absaugung eine in das Flüssigkeitsbad führende Rückführung aufweist. Auf diese Weise kann die gesamte Flüssigkeit gegebenenfalls nach Reinigung in einer Filtervorrichtung dem Behandlungsbad wieder zugeführt werden, so daß Verluste an Badflüssigkeit weitgehend vermieden werden, wobei gleichzeitig die Badflüssigkeit auf diese Weise laufend gefiltert wird.

Bei einer ersten bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, daß die Absaugung im Innern des Flüssigkeitsbades angeordnet ist. Das Flüssigkeitsbad kann dabei ein Bad einer beliebigen Behandlungsflüssigkeit sein, beispielsweise ein Reinigungs-, ein Vorbehandlungs-, ein Aktivierungs-, ein Neutralisierungs- oder auch ein Abscheidungsmedium, je nachdem welche Behandlung an der Leiterplatte jeweils vorgenommen werden soll. Dabei ist unter Umständen die Durchströmung der Bohrlöcher nicht nur zu Reinigungszwecken notwendig, sondern auch um den Kontakt der Behandlungsflüssigkeit mit den Bohrlochwänden zu garantieren, wenn nämlich die Behandlungsflüssigkeit die Bohrlochwände bearbeitet, beispielsweise beim chemischen oder physikalischen Aufrauen der Bohrlochinnenwand. Eine Behandlungsflüssigkeit kann auch ein flüssiges Lot sein. Die Anordnung kann auch angewendet werden beim Abscheiden von Aktivatoren an den Bohrungswandungen und beim chemischen Abscheiden, z.B. von Kupfer, und beim galvanischen Verstärken chemischer Abscheidungen.

Eine besonders vorteilhafte Reinigungswirkung ergibt sich dann, wenn auf der der Absaugung abgewandten Seite der Leiterplatte eine Ultraschallreinigungsvorrichtung in der Flüssigkeit angeordnet ist, wobei diese vorzugsweise der Absaugung unmittelbar gegenüberliegt.

Die Durchströmung der Bohrlöcher wird unterstützt, wenn der Absaugung gegenüber eine die Flüssigkeit gegen die Leiterplatte richtende Fördereinrichtung angeordnet ist. Beispielsweise kann eine sogenannte Schwallwelle vorgesehen sein, die Behandlungsflüssigkeit von unten nach oben durch eine Leiterplatte durchdrückt. Die Absaugung befindet sich dann auf der Oberseite in dem Bereich der Flüssigkeit, der über die Oberseite der Leiterplatte hervortritt, so daß in diesem Bereich die Behand-

lungsflüssigkeit nach dem Durchströmen der Leiterplatte abgesaugt wird und nicht auf die Oberfläche der Leiterplatte gelangt, auf der Verunreinigungen in dieser Behandlungsflüssigkeit abgelagert werden könnten.

Bei einem weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, daß die Absaugung in Förderrichtung einer Leiterplatte stromabwärts der Austrittsstelle einer Leiterplatte aus einem Flüssigkeitsbad angeordnet ist. Leiterplatten, die ein Flüssigkeitsbad verlassen, werden beispielsweise durch an beiden Oberflächen anliegende Abquetschwalzen von Behandlungsflüssigkeit befreit, jedoch verbleiben auch nach dieser Entfernung der Behandlungsflüssigkeit noch erhebliche Flüssigkeitsmengen in der Leiterplatte, teilweise im Innern der Bohrlöcher, teilweise an Oberflächen und Vertiefungen der Oberflächen. Auf diese Weise werden bei bekannten Behandlungsvorrichtungen große Mengen der Behandlungsflüssigkeit verschleppt, die vor dem Eintritt einer Leiterplatte in eine weitere Behandlungsstation von der Leiterplatte abgespült werden müssen, um eine unerwünschte Reaktion in der nächsten Behandlungsstation zu vermeiden.

Es hat sich nun als außerordentlich günstig herausgestellt, die an den Leiterplatten verbleibende Flüssigkeitsmenge nicht durch große Mengen von Spülwasser zu beseitigen, sondern durch eine Absaugung. Diese entfernt die verschleppte Flüssigkeit sowohl aus den Bohrlöchern als auch von der Oberfläche der Leiterplatte außerordentlich vollständig, wobei gleichzeitig mit der Flüssigkeit auch Luft angesaugt wird. Das Luft-Flüssigkeitsgemisch kann im Zuge der Rückführung getrennt werden, so daß die rückgewonnene Behandlungsflüssigkeit dem Behandlungsbad wieder zugeführt werden kann.

Auf diese Weise wird die verschleppte Flüssigkeit so vollständig von den Leiterplatten entfernt, daß eine Spülung vor dem Eintritt in die nächste Behandlungsstation entweder ganz entfällt oder aber in ihrem Ausmaß erheblich reduziert werden kann. Dadurch lassen sich einerseits die Spülprozesse mit wesentlich weniger Spülflüssigkeit, zum Beispiel Wasser, durchführen und außerdem wird die Spülflüssigkeit wesentlich weniger belastet als bei bekannten Vorrichtungen.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn beiden Seiten der Leiterplatte je mindestens eine Absaugung zugeordnet ist, wobei die Absaugungen einander unmittelbar gegenüberliegend angeordnet sein können, sie können aber in Transportrichtung der Leiterplatten auch gegeneinander versetzt sein.

Bei der bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, daß die Absaugung eine Fluidstrahlpumpe umfaßt, beispielsweise eine Wasserstrahlpumpe. Diese hat sich zur Absaugung von Behand-

lungsflüssigkeit als besonders geeignet erwiesen, obwohl natürlich anstelle einer solchen Fluidstrahlpumpe auch Pumpen anderen Typs Verwendung finden können.

Die Absaugung weist vorzugsweise einen sich quer zur Leiterplatte erstreckenden Absaugeschlitz auf, an dem die Leiterplatte vorbeibewegt wird, so daß die gesamte Oberfläche der Leiterplatte von dem Absaugeschlitz überstrichen wird. Quer bedeutet dabei vorzugsweise senkrecht zur Förderrichtung, es ist jedoch auch möglich, den Absaugeschlitz unter einem Winkel relativ zur Förderrichtung anzuordnen, beispielsweise unter einem Winkel von 45° .

Günstig ist es, wenn der Absaugeschlitz eine Schlitzbreite zwischen 0,2 und 5 mm hat.

Eine besonders effektive Absaugung erhält man, wenn der Abstand der Absaugung von der Leiterplatte zwischen 0,1 und 5 mm liegt.

Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen dient im Zusammenhang mit der Zeichnung der näheren Erläuterung. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Längsschnittansicht einer Behandlungsstation mit einer Absaugung an der Unterseite einer Leiterplatte;

Fig. 2 eine Ansicht ähnlich Fig. 1 mit einem zusätzlichen Ultraschallschwinger auf der Oberseite der Leiterplatte und

Fig. 3 eine Längsschnittansicht einer Behandlungsstation und einer daran anschließenden Absaugung zur Herabsetzung der Flüssigkeitsverschleppung.

Die in Fig. 1 dargestellte Behandlungsstation 1 umfaßt einen Behälter 2, in dessen Vorderwand 3 und Rückwand 4 jeweils ein horizontaler Schlitz 5 bzw. 6 angeordnet ist, die in derselben Horizontalebene liegen. In jedem der Schlitze 5 und 6 ist jeweils ein Walzenpaar 7 bzw. 8 angeordnet mit zwei einander gegenüberliegenden, längs des Schlitzes verlaufenden Walzen, von denen die obere in aus der Zeichnung nicht ersichtlicher Weise unter der Wirkung des Eigengewichtes oder einer Feder gegen die untere gedrückt ist. In dem Behälter 2 können sich weitere Walzenpaare 9 befinden, die zusammen mit den Walzenpaaren 7 und 8 eine Vorschubebene 10 für Leiterplatten 11 bilden.

Der Behälter 2 ist mit einer Behandlungsflüssigkeit 12 gefüllt, die durch geeignete, in der Zeichnung nicht dargestellte Pumpen in einer solchen Menge in den Behälter 2 eingeführt wird, daß der Behandlungsflüssigkeitsspiegel 13 sich oberhalb der Schlitze 5 und 6 einstellt.

An der Unterseite der Vorschubebene 10 ist eine Absaugung 14 angeordnet, die über eine Absaugungleitung 15 zu einer in der Zeichnung nicht dargestellten Pumpe führt, beispielsweise einer Strahlpumpe mit Injektordüse. Die Absaugung 14

selbst umfaßt einen sich quer zur Vorschubrichtung über die gesamte Breite der Vorschubebene erstreckenden Absaugschlitz 16, der beispielsweise eine Breite zwischen 0,2 und 0,5 mm aufweisen kann und in einem Abstand zwischen 0,1 und 5 mm unterhalb der Vorschubebene 10 endet.

Im Betrieb der beschriebenen Behandlungsstation 1 ist der Behälter mit einer Behandlungsflüssigkeit 12 gefüllt, die für den jeweiligen Behandlungsschritt benötigt wird. Es kann sich dabei um eine Vielzahl unterschiedlicher Flüssigkeiten handeln, beispielsweise um Reinigungsflüssigkeiten, Vorbehandlungsflüssigkeiten, Aktivierungs- oder Neutralisierungsflüssigkeiten oder Abscheidungsflüssigkeiten, in manchen Fällen auch Öle oder flüssige Lote.

Beim Durchtritt einer Leiterplatte durch den Behälter 2 längs der Vorschubebene 10 überstreicht der Absaugschlitz 16 der Absaugung 14 die gesamte Leiterplattenoberfläche. In diesem Bereich wird Behandlungsflüssigkeit von der Oberseite durch die Bohrungen der Leiterplatte hindurch auf die Unterseite gesaugt und tritt dann in den Absaugschlitz 16 ein, so daß einerseits eine besonders wirksame Durchflutung der Bohrlöcher erreicht wird und andererseits vermieden wird, daß bei der Durchflutung von der Behandlungsflüssigkeit mitgenommene Verunreinigungen in die Behandlungsflüssigkeit 12 des Behälters 2 gelangt. Diese Verunreinigungen gelangen mit der abgesaugten Flüssigkeit in die Absaugleitung 15 und werden nach Durchströmen eines in der Zeichnung nicht dargestellten Filters wieder in den Behälter 2 eingeführt.

Bei der in Fig. 1 dargestellten Behandlungsstation 1 ist eine einzige Absaugung 14 an der Unterseite der Leiterplatte dargestellt. Derartige Absaugungen können sowohl an der Unterseite als auch an der Oberseite der Leiterplatte vorgesehen werden, wobei auch die Zahl der auf jeder Seite angeordneten Absaugungen je nach den Anforderungen größer gewählt werden kann.

Die Wirkung der Absaugung kann dadurch unterstützt werden, daß der Absaugung gegenüber einer Zufuhr für die Behandlungsflüssigkeit vorgesehen ist, beispielsweise kann die Flüssigkeitseinkleitung in den Behälter 2 einer Absaugung gegenüber angeordnet sein.

Das in Fig. 2 dargestellte Ausführungsbeispiel entspricht weitgehend dem der Fig. 1, gleiche Teile tragen daher dieselbe Bezugszeichen. Zusätzlich zum Ausführungsbeispiel der Fig. 1 ist bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2 der Absaugung 14 gegenüber ein Ultraschallschwinger 17 in der Behandlungsflüssigkeit angeordnet, so daß die Reinigungswirkung der strömenden Flüssigkeit durch diesen Ultraschallschwinger noch unterstützt wird.

Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 3 ist

eine weitere Behandlungsstation 1 dargestellt, die an sich gleich aufgebaut sein kann wie bei den Ausführungsbeispielen der Fig. 1 und 2. Auch hier sind entsprechenden Teilen dieselben Bezugszeichen zugeordnet. Zusätzlich sind jedoch in Förderichtung der Leiterplatten stromabwärts der Behandlungsstation 1 auf der Unterseite und auf der Oberseite der Leiterplatten zusätzliche Absaugungen 24 vorgesehen, die ebenfalls über Absaugleitungen 25 mit einer Saugpumpe verbunden sind. Von der Saugpumpe führt eine Rückführleitung in die Behandlungsstation 1 zurück.

Im Unterschied zu der im Innern der Behandlungsstation angeordneten Absaugung befinden sich die Absaugungen 24 in einer gasförmigen Umgebung, normalerweise in Luft, so daß über den Absaugschlitz 26 der Absaugung 24 von den vorbeigeführten Leiterplatten ein Gemisch aus Behandlungsflüssigkeit und Umgebungsgas angesaugt wird. Dabei reißt die angesaugte Luft die an der Leiterplatte haftenden Teilchen der Behandlungsflüssigkeit besonders wirksam von der Leiterplatte weg, so daß auf diese Weise eine sehr vollständige Entfernung der Behandlungsflüssigkeit von der Leiterplatte erreicht werden kann. Das Gas-Flüssigkeitsgemisch kann anschließend getrennt werden, so daß die reine Behandlungsflüssigkeit der Behandlungsstation 1 wieder zugeführt werden kann. Dadurch kann die Verschleppung der Behandlungsflüssigkeit so weitgehend reduziert werden, daß eine anschließende Spülung unter Umständen ganz wegfallen kann oder zumindest jedoch der Spülaufwand ganz erheblich herabgesetzt wird.

Ansprüche

1. Vorrichtung zur Behandlung von elektrischen Leiterplatten (11) in einem oder mehreren Flüssigkeitsbädern (2), gekennzeichnet durch eine mindestens an einer Oberfläche der Leiterplatte (11) angeordnete Absaugung (14, 24).

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Absaugung (14, 24) eine in das Flüssigkeitsbad (2) führende Rückführung aufweist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Absaugung (14) im Innern des Flüssigkeitsbades (2) angeordnet ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß auf der der Absaugung (14) abgewandten Seite der Leiterplatte (11) eine Ultraschallreinigungsvorrichtung (17) in der Flüssigkeit (12) angeordnet ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Ultraschallreinigungsvorrichtung (17) der Absaugung (14) unmittelbar gegenüber angeordnet ist.

6 Vorrichtung nach einer der Ansprüche 3, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Absaugung (14) gegenüber eine die Flüssigkeit (12) gegen die Leiterplatte (11) richtende Fördereinrichtung angeordnet ist.

7 Vorrichtung nach einer der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Absaugung (24) in Förderrichtung einer Leiterplatte (11) stromabwärts der Austrittsstelle einer Leiterplatte (11) aus einem Flüssigkeitsbad (2) angeordnet ist.

8 Vorrichtung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß den beiden Seiten der Leiterplatte (11) je mindestens eine Absaugung (14, 24) zugeordnet ist.

9 Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Absaugung (14) eine Fluidstrahlpumpe umfaßt.

10. Vorrichtung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Absaugung (14) einen sich quer zur Leiterplatte (11) erstreckenden Absaugschlitz (16, 26) aufweist und daß die Leiterplatte (11) an diesem vorbeibewegt wird.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Absaugschlitz (16, 26) eine Schlitzbreite zwischen 0,2 und 5 mm hat.

12. Vorrichtung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand der Absaugung (14, 24) von der Leiterplatte (11) zwischen 0,1 und 5 mm liegt.

Geänderte Patentansprüche gemäß Regel 86(2) EPU

1. Vorrichtung zur Behandlung von elektrischen Leiterplatten (11) in einem oder mehreren Flüssigkeitsbädern (2) mit einer an mindestens einer Oberfläche der Leiterplatte (11) angeordneten Absaugung (14, 24), **dadurch gekennzeichnet**, daß die Absaugung (14) im Innern des Flüssigkeitsbades (2) angeordnet ist und daß der Absaugung (14) gegenüber eine die Flüssigkeit (12) gegen die Leiterplatte (11) richtende Fördereinrichtung angeordnet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Absaugung (14, 24) eine in das Flüssigkeitsbad (2) führende Rückführung aufweist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß auf der der Absaugung (14) abgewandten Seite der Leiterplatte (11) eine Ultraschallreinigungsvorrichtung (17) in der Flüssigkeit (12) angeordnet ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Ultraschallreinigungsvorrichtung (17) der Absaugung (14) unmittelbar gegenüber angeordnet ist.

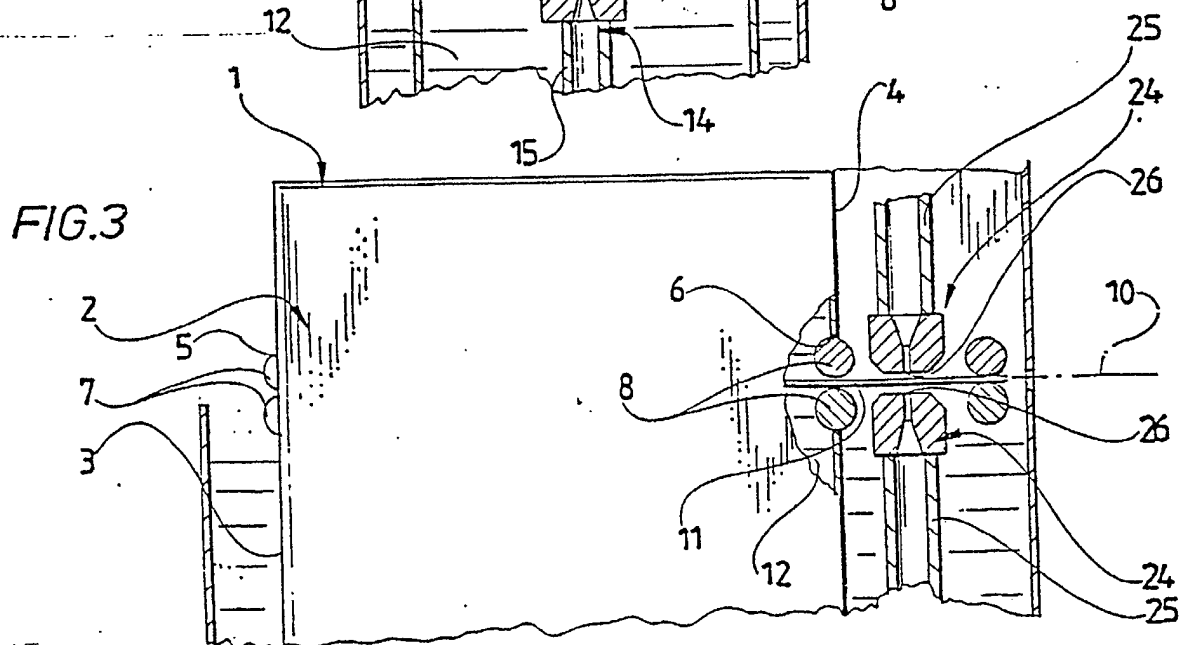
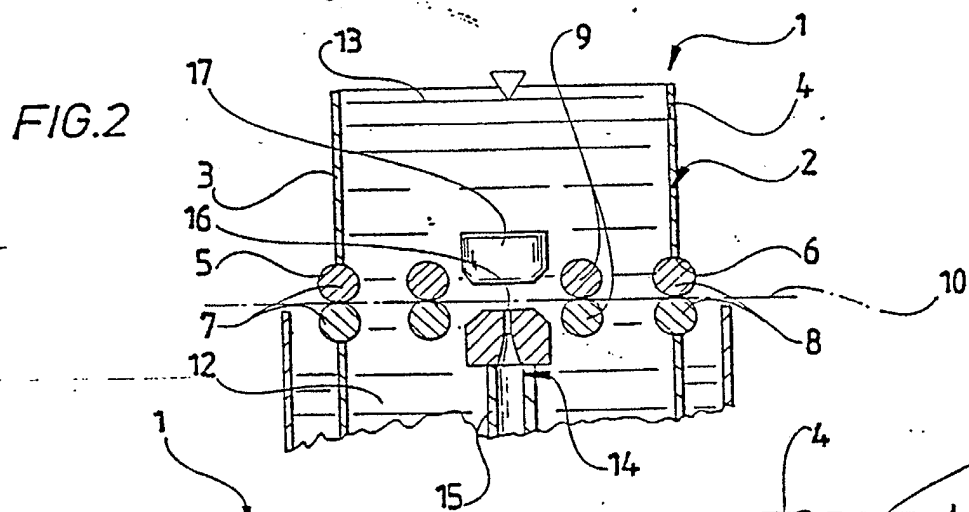
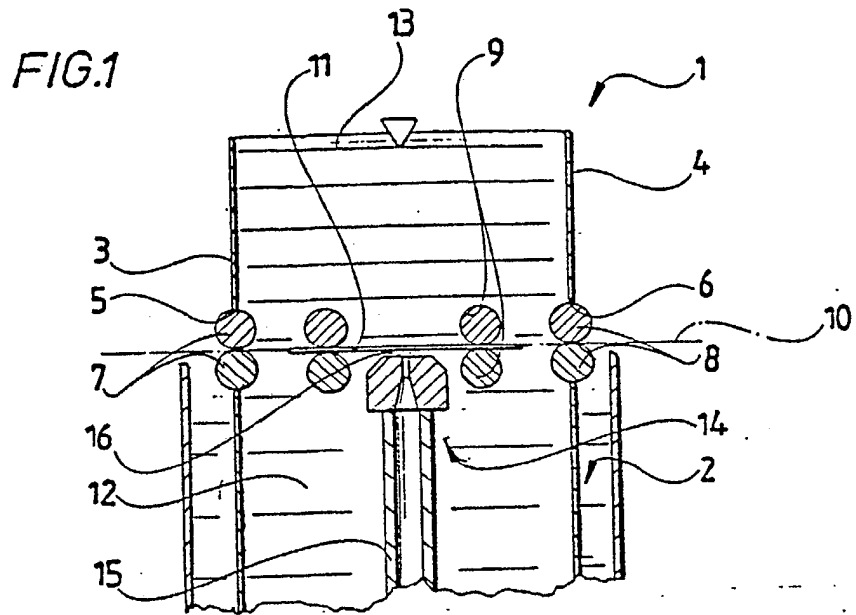
5. Vorrichtung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß den beiden Seiten der Leiterplatte (11) je mindestens eine Absaugung (14, 24) zugeordnet ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Absaugung (14) eine Fluidstrahlpumpe umfaßt.

7. Vorrichtung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Absaugung (14) einen sich quer zur Leiterplatte (11) erstreckenden Absaugschlitz (16, 26) aufweist und daß die Leiterplatte (11) an diesem vorbeibewegt wird.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Absaugschlitz (16, 26) eine Schlitzbreite zwischen 0,2 und 5 mm hat.

9. Vorrichtung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand der Absaugung (14, 24) von der Leiterplatte (11) zwischen 0,1 und 5 mm liegt.





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 88 10 2800

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
Y	DE-A-2 606 984 (SIEMENS) * Seite 1, Anspruch 1; Figur 1 * ---	1	H 05 K 13/00 H 05 K 3/26
Y	FR-A-2 412 357 (SCHERING) * Seite 8, Ansprüche 1,2; Figuren 1-3 *	1	
A	---	2,8	
A	EP-A-0 204 609 (O.S.L.) * Spalte 7, Zeile 34 - Spalte 8, Zeile 16; Figuren 1-3 * -----	1,4,5	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
			H 05 K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 13-10-1988	Prüfer LOMMEL A.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1503 03.82 (P0403)